

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

佛山市蓝箭电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1、平安证券：姚彦、王湘、张斌、邓建锋、陈威宇、颜英樑、谢思红、胡刚 2、睿华资本：朱崇玮 3、赵凯靖、吴焕林、李嘉、邓建锋、冯佩颜、徐广林、黄崇辉、陈洁芝、李锡昌、冯可成、尹宗嫦、刘涛、傅肖泳、何炽坚、周子欣、黄日军、许艳芳、魏宏让、曾晖、郑莉莉
时间	2024年6月20日
地点	佛山市禅城区古新路45号佛山市蓝箭电子股份有限公司5楼会议室
上市公司接待人员姓名	1、副总经理、董事会秘书张国光 2、证券事务代表林品旺
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>1：2023年年报、2024年一季度财报显示，扣非净利润2023年四季度首次录的负值，请问净利润转负的直接原因是什么？管理层做了那些应对措施，展望后市是否有消除的迹象？</p> <p>答：2023年以来，主要是受国内外经济形势变化和下游消费类电子产品等市场需求的变化，以及叠加下游客户处于去库存阶段的综合影响，市场竞争加剧使得公司产品销售价格下滑，导致利润和销售收入同比有所下降。</p> <p>面对半导体封测行业激烈竞争的态势，公司将着眼行业前瞻性，坚持稳中求进策略，提升技术研发水平。公司将进一步拓宽产品应用面，丰富产品系列，优化产品结构，推动产品迭代升级，集中资源攻关汽车电子、工控类等高附加值产品，稳步提升公司</p>

业绩。

2、请问公司目前客户结构情况如何？

答：公司自成立以来坚持以技术创新为核心，凭借多年丰富的行业经验积累以及自主研发能力，秉承“以客户需求为中心”的服务理念，获得行业内客户的广泛认可。经过多年发展与积累，公司主要产品应用于消费类电子、工业控制、智能家居、安防、网络通信、汽车电子等多个领域，多年来公司与客户建立了长期稳定的合作关系。随着信息技术的快速发展，未来物联网、人工智能、通讯网络及汽车行业的更新迭代，公司将持续研发投入、积极技术创新，在工业类、车规级产品研发、氮化镓快充等多项前沿技术领域开发新的产品，为公司未来收入增长提供有力支持。

3、请问公司对下游行业情况有何看法和分析？

答：首先，从产品下游应用领域看，公司主要产品应用于消费类电子、工业控制、智能家居、安防、网络通信、汽车电子等多个领域。现在整个电子行业中汽车电子领域受益于新能源汽车的普及，景气度相对较好，市场需求有所增长；而其他消费类产品如手机、笔记本、PC目前整体需求有所下降；TV、路由器、空调等需求基本持平；其次，对于新型的消费类电子产品应用，如扫地机、洗地机、空气炸锅、蓝牙耳机等，此类产品适应市场需求变化波动较大。再次，目前受到宏观经济疲软和终端市场需求疲软的影响，消费信心不足，消费习惯偏保守等因素影响了电子产品需求。总体上，目前下游市场需求还在逐步恢复过程中。

4、请问公司针对国产替代方面的看法？

答：对中国产业发展而言，中美贸易摩擦及升级对中国半导体出口限制影响，国产化替代转为促进动能，政策和资本加持成为推动中国半导体行业突围的关键。目前半导体国产化占有率偏低，市场终端智能电子产品、清洁能源、大数据等各种技术不断发展产生新需求，同时、半导体本身技术也在不断更新迭代；宏观方面，国家在大力发展半导体技术。综上，未来半导体发展的空间依然乐观。

5、请问公司国内与国际业务主营范围是何种关系，目前国际关系对公司的影响如何？

答：公司主要以境内销售为主，公司主营业务收入主要来源于华南地区和华东地区。华南、华东市场覆盖了我国经济最为发达的珠江三角洲、长江三角洲经济区，半导体制造产业集聚程度较高，下游应用领域家用电器、信息通信及其他电子产品制造业发达，生产企业众多。公司境外销售收入目前占比较低，其主要来源于中国香港、韩国、新加坡，在目前国际环境条件下不会对

公司造成较大影响。

6、请问公司人才培养和储备的方式如何？

答：首先根据公司战略规划及年度经营计划，将大力引进高端人才、专业技术人才，重点引进封装工艺技术研发、营销等方面的专业人才，逐步建立较为完善的人才引进与培养机制，提升公司核心竞争力。公司将通过互联网发布招聘信息，与各大高校合作招聘，推行产学研结合机制并寻求外部研发合作等方式吸收专业技术人才，通过各种方式补充相应的人才以适应公司不断发展的需要。同时，公司将继续完善内部人才的培养机制，以部门为单位，再结合不同岗位的职责要求，制定年度培训计划，有针对性的服务各类员工培训需求，以实现员工个人技能提升与公司持续发展统一结合。

公司目前拥有一百多人组成的研发队伍，核心技术人员均拥有 20 年以上半导体行业工作经验，已形成了一支由高级工程师带队、工程师为骨干的优秀研发团队。此外，公司重视和科研院所等机构的合作研发，与中山大学、西安电子科技大学、工信部电子第五研究所等国内知名高校和研究机构进行紧密合作。

7、请问公司是否考虑使用股权激励等方式锁定核心关键技术人才？

答：公司高度重视核心技术人员的研发活动和激励机制（包括不限于后续会考虑股权激励等方式），制订了科技人员培养、考核、奖励制度，采用市场化的薪酬体系，全面评价核心技术人员，保证核心技术人员的稳定性，激发核心技术人员的创新活力。截至目前公司核心技术人员稳定，不存在变动情况。

8、在这个封装行业市场充分竞争的状态如何保持核心竞争力？

答：首先，目前公司的核心优势有：1、持续加大研发投入、具备先进生产能力；2、拥有良好的客户基础；3、拥有稳健的生产管理体系及完整的半导体封装测试技术，积极开拓新兴领域；4、拥有稳定的多学科、多专业、多背景的人才队伍。

其次：公司作为一家主要从事半导体封装测试的国家级高新技术企业，具有较为完善的研发、采购、生产、销售体系。公司将结合半导体行业的发展趋势，聚焦应用于物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智能电网、5G 通信射频等具有广阔发展前景的新兴领域，进一步加大宽禁带功率半导体器件和 Clip bond 封装工艺等方面的研发创新。同时，公司将扩大产品开发、优化产品结构，积极开拓新客户，提升公司产品品牌影响力，提高公司经营管理水平及核心竞争力。

9、请问公司如何看待国家三期大基金的落地，与公司发展方向匹配情况？

答：半导体产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和

社会发展的战略性产业，国家给予了高度重视和大力支持。我国半导体技术水平及产业规模与欧美、日韩等发达国家或地区相比，尚存在差距，国产化程度偏低。特别是近年来，市场终端智能电子产品、清洁能源、大数据等各种技术不断发展产生新需求，中美贸易摩擦及升级对华半导体出口限制，导致行业供需矛盾突出。

为推动我国以集成电路为主的半导体产业发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策：国家三期大基金的成立，可以进一步推动我国半导体行业的创新发展，加快关键技术的国产化进程，保障半导体产业供应链的安全与自主可控。同时公司也一直以来密切关注国家关于行业及资本市场高质量发展的相关支持政策，及时把握机遇赋能公司发展。

公司深耕半导体行业领域，国家法规政策在财税、资本、人才培养等多方面扶持，为本公司经营稳定发展，创造了积极良好的政策环境。公司力争在行业法规政策的积极推动下，继续发挥自身技术优势，巩固市场地位，提高产品全球市场竞争力，为促进我国芯片国产化进程做出贡献。

10、国家三期大基金的落地对公司未来的发展是否存在行业扩张过快产能过剩的挑战还是其他新的机遇？

行业扩产需结构化看待，目前随着新兴市场高端产品应用需求的提升，经过公司长期运营判断，目前市场产能需求还是属于良性发展；目前因为中美贸易摩擦等因素影响，半导体出现有短暂性过热发展的现状。

目前，半导体国产化占有率偏低，市场终端智能电子产品、清洁能源、大数据等各种技术不断发展产生新需求，同时，半导体本身技术也在不断更新迭代；宏观方面，国家在大力发展半导体技术。综上，未来半导体发展的空间依然乐观。

11、请问公司在未来增速主要关注哪些方面？

答：公司将结合半导体行业的发展趋势，聚焦应用于物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智能电网、5G 通信射频等具有广阔发展前景的新兴领域，进一步加大宽禁带功率半导体器件和 Clip bond 封装工艺等方面的研发创新；同时，公司将顺应集成电路封测技术发展趋势，将在晶圆级芯片封装以及系统级封装上加大投入。在已掌握的系统级封装 SIP 技术上，不断拓宽集成电路封测服务技术水平和产品覆盖范围，逐步开始探究 Bumping、MEMS、Fan-out 等多项封装技术，集成电路封测产品在原有模拟电路基础上，逐步拓宽覆盖范围，拓展和提升数字电路和传感器等多个领域封测能力。此外，公司将扩大产品开发、优化产品结构，积极开拓新客户，提升公司产品品牌影响力，提高公司经营管理水平，致力将公司发展成为行业内领先的封测企业。

附件清单(如有)	无
日期	2024年6月20日